
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

董事認為，[編纂]將有利於我們為持續增長及進一步擴張業務實施業務策略。作為中國ODM手機供應商前10之一，我們致力透過強大的研發能力維持於目標新興市場的市場份額及擴大產品組合，以多樣化我們的收入來源，各項策略載於本文件「業務 — 業務策略」。

[編纂]的理由

為實現本集團的業務策略及實施我們的計劃，經考慮以下因素，董事認為透過[編纂]獲得額外資金可令本集團受益：

- 作為業務策略之一部分，我們鎖定新興市場的當地領先手機供應商及電訊營運商為我們的潛在客戶。董事認為，公開[編纂]地位可提升公司形象及認可度，有利於取得銷售訂單，亦將吸引研發人才，有益於長期業務增長；
- 為提升成本效益及鞏固我們作為向客戶提供一站式ODM服務的垂直綜合手機供應商的地位，我們需要資金增強自身實力，提高印刷電路板組裝的貼片產能，以滿足客戶對手機及印刷電路板組裝的需求；
- 為適應技術變化，由於預期將推行5G網絡及普及5G手機，董事認為額外資金可令我們增加研發資源，以解決5G相關產品的快速、順利驗證；及
- 由於物聯網於中國及全世界日漸普及，董事認為，倘我們擁有額外資金可撥付研發及為物聯網相關產品(包括智能定位器、智能音響及智能鎖)進行市場推廣，則可補充我們的產品類別，更快地增加我們的收益驅動力。

我們進一步闡述[編纂]的商業理由及實際融資需求如下。

本集團實際的融資需求

於往績記錄期間，我們主要依賴我們的內部資源及銀行融資(包括已貼現票據貸款及保理貸款)為我們的業務營運提供資金。於二零一九年四月三十日，我們的銀行結餘及現金人民幣49.8百萬元及信貸融資人民幣203.9百萬元均已悉數動用。根據我們於截至二零一八年十二月三十一日止年度的業務營運範圍，我們的平均每月營運成本(包括銷售成本、銷售開

未來計劃及[編纂]用途

支、行政及其他開支(不包括[編纂]開支)及研發開支)為約人民幣182.6百萬元。我們於二零一八年十二月三十一日的銀行結餘及現金約人民幣49.8百萬元僅足夠滿足我們約一周的營運成本，因此，我們亦需要銀行融資以為我們的營運提供資金。

於往績記錄期間，我們分別籌集新借貸人民幣655.4百萬元、人民幣1,050.2百萬元、人民幣492.8百萬元及人民幣439.4百萬元，其中人民幣655.4百萬元、人民幣979.0百萬元、人民幣492.8百萬元及人民幣439.4百萬元為附追索權的已貼現票據貸款。該等已貼現票據貸款為短期及按介乎0.23%至3.72%的較低年利率計息，因為該等貸款由我們客戶指定的銀行出具的信用證作擔保。該等已貼現票據貸款通常於信用證日期起60至90日到期，即我們的銀行自出具信用證的銀行收取付款時。由於已貼現票據貸款為短期並需要信用證作為抵押，所以彼等用作支付我們的運營成本，而非長期資本開支。由於於往績記錄期間使用債務融資為業務運作提供資金，我們產生大量的融資成本並錄得較高的資產負債率。

除使用內部資源及債務融資為我們的業務運營提供資金外，我們在二零一八財年增加了從接受銀行承兌票據的供應商的採購，以改善我們的流動資金。未付票據由二零一七年十二月三十一日的人民幣30.9百萬元大幅增加至二零一八年十二月三十一日的人民幣307.0百萬元並於二零一九年四月三十日維持相對穩定於人民幣316.1百萬元。向我們的供應商開具銀行承兌票據的銀行要求我們提供相等於銀行承兌票據面值100%的抵押品(銀行存款及/或按公平值計入損益的金融資產)。於二零一九年四月三十日，按公平值計入損益的金融資產的全部金額人民幣316.2百萬元，連同若干銀行存款已抵押予銀行以開具銀行承兌票據。由於按公平值計入損益的金融資產產生的利息收入高於銀行存款，我們將分配更多的資金至按公平值計入損益的金融資產，其後將其抵押予銀行以開具銀行承兌票據。

[編纂]可以縮短本集團實施擴張計畫及抓住市場增長所需時間

按ODM基準的手機製造是一項資本密集型的業務，乃由於我們須投入大量的資源購置物業、廠房及設備以及進行研發。

根據灼識諮詢報告，於二零一八年，中國智能手機出貨量按地區排名第一，佔全球智能手機出貨量的30.6%，其次是亞洲新興國家(不包括中國)及北美，分別佔17.5%和13.5%。於二零一八年至二零二三年，全球智能手機市場將繼續增長，因為5G智能手機的推出及亞洲新興國家可支配收入增加預計將刺激消費者對新手機的需求。

未來計劃及[編纂]用途

我們的董事相信有足夠的生產能力及研發能力的手機製造商將受益於上述市場增長，因此對我們而言至關重要是持續投入資本資源獲得新的生產線、研發設備、僱傭額外人才及開展研發捕捉亞洲新興國家的潛在市場增長。我們的董事亦認為，擴大我們的生產能力及提高生產能力可提高成本及生產效率。

儘管上文所述，建立及擴展生產廠房需耗費時間。我們需要(i)在進行全面生產前對新生產線安裝及進行試運營；及(ii)培訓新招募人員。由於能夠穩定供應優質印刷電路板組裝乃為成功供應手機的關鍵，故我們藉助當地的鼓勵政策並於二零一八年設立瀘州廠房以為手機印刷電路板組裝生產貼片。由於我們的深圳廠房配備了十條手機裝配線，故我們於二零一八年四月建立瀘州廠房，其配備了四條貼片線及年產能達2.5百萬件。由於成本效率，我們一般生產智能手機而非功能型手機所用的印刷電路板組裝。於二零一八財年，我們智能手機的銷售量達7.1百萬台及作為獨立產品我們亦出售合共1.5百萬件智能手機印刷電路板組裝。因此，我們於二零一八財年所消耗的智能手機印刷電路板組裝的總量為8.6百萬件。根據我們瀘州廠房現有的年化產能，我們可能仍須向電子設備服務提供商外包大部分智能手機印刷電路板組裝的裝配工作。於二零一八年瀘州廠房試運營順利後(其成本效益分析載於下文)，我們的管理層認為我們可繼而為瀘州廠房提高產能以提升本集團的成本及生產效率及達致更好的質量控制。

為瀘州廠房額外增配兩條貼片生產線(「新貼片線」)的成本效益分析

假設

我們在進行成本效益分析時作出以下主要假設：

- 1) 鑒於本集團不論自行生產印刷電路板組件還是將組裝工程外包予電子製造服務供應商，均應採購組裝工程使用的原材料及部件，計算不計入原材料及部件成本。
- 2) 鑒於根據瀘州高新技術產業開發區管理委員會及深圳禾苗於二零一七年八月訂立的投資合作協議，瀘州高新技術產業開發區管理委員會同意在滿足若干條件的情況下，前三年給予100%租金補貼，第四年及第五年給予50%租金補貼，我們假設本集團就瀘州廠房將不會產生任何租金費用，因此計算不計入租金開支。
- 3) 新貼片線將獲悉數動用。

未來計劃及[編纂]用途

- 4) 每條貼片線每月的其他額外成本與二零一九年第一季度確認的瀘州廠房現有四條貼片線的其他額外成本相同。

成本效益分析

下表載列於二零一八財年，(i)本集團增設新貼片線並自行就4G智能手機組裝印刷電路板組件將會產生的平均成本；及(ii)將組裝工程外包予電子製造服務供應商的平均分包費用。

透過增設新貼片線組裝4G智能手機印刷電路板組件的平均成本

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 每年額外勞工成本(人民幣元)(附註1) | [編纂] |
| 每年額外設備折舊(人民幣元)(附註2) | [編纂] |
| 每年其他額外成本(人民幣元)(附註3) | [編纂] |
| 每年額外成本總額(人民幣元) | [編纂] |
| 新貼片線的年產能(件)(附註4) | 1,267,200 |
| 透過新貼片線組裝4G智能手機印刷電路板組件的平均成本(人民幣元/件) | 7.88 |

附註：

1. 每年額外勞工成本等於本集團為支持增設的新貼片線而計劃招聘的100名員工的年度成本。
2. 每年額外設備折舊乃按直線折舊法計算並假設10年可使用年期。設備成本等於本集團為增購新貼片線而計劃動用的[編纂]。
3. 每年其他額外成本指在本集團增設新貼片線的情況下於生產中產生的公用事業開支及其他間接費用，按本集團於二零一九年第一季度就瀘州廠房的現有四條貼片線確認的每條貼片線的月均其他成本計算。
4. 新貼片線的年產能乃按每條貼片線每小時300件乘以兩條貼片線、每天8個工時及每年264個工作日計算。

將組裝工程外包予電子製造服務供應商的平均成本

| | |
|--|------------|
| 二零一八財年將4G智能手機印刷電路板組件的組裝工程外包予電子製造服務供應商的分包費用(人民幣元) | 20,626,688 |
| 二零一八財年外包予電子製造服務供應商的4G智能手機印刷電路板組件數量(件) | 2,245,722 |
| 二零一八財年的平均分包費用(人民幣元/件) | 9.18 |

未來計劃及[編纂]用途

倘我們購買新貼片，組裝4G智能手機印刷電路板組件的平均成本將約為每件人民幣7.88元。與二零一八財年將組裝工程外包予電子製造服務供應商的成本約每件人民幣9.18元(即分包費用)相比，我們透過於瀘州廠房增設新貼片線安裝的4G智能手機印刷電路板組件每件將節約約人民幣1.30元或約14.2%。

還本期分析

我們在進行還本期分析時作出以下主要假設：

假設

- 1) 新貼片線將獲悉數動用。
- 2) 4G智能手機的平均售價與二零一八財年的平均售價相同。
- 3) 4G智能手機的純利潤率將等於本集團於二零一八財年錄得的純利潤率。

還本期分析

下表載列新貼片線還本期的計算：

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 新貼片線的年產能(件) (附註) | 1,267,200 |
| 4G智能手機(使用來自新貼片線的印刷電路板組件組裝)的 年銷量(件) | 1,267,200 |
| 二零一八財年4G智能手機的平均售價(人民幣元) | 348 |
| 銷售上述4G智能手機所得年收入(人民幣元) | 440,985,600 |
| 二零一八財年的純利潤率 | 1.5% |
| 銷售上述4G智能手機所得純利(人民幣元) | 6,614,784 |
| 新貼片線的初始投資(人民幣元) | 29,382,500 |
| 還本期(年) | 4.4 |

附註：新貼片線的年產能乃按每條貼片線每小時300件乘以兩條貼片線、每天8個工時及每年264個工作日計算。

購買新貼片線的還本期將約為4.4年。

鑒於(i)就本集團而言，自行生產印刷電路板組件比將生產分包予分包商低廉；(ii)我們自行生產可更好的控制生產時間表；及(iii)新貼片線的成本將於約4.4年內收回，董事認為購買新貼片線以擴大產能符合本公司及股東最佳利益。

未來計劃及[編纂]用途

ODM手機行業競爭激烈。倘我們並無具充足的產能及能力以迎合市場需求，我們的潛在客戶將易於轉向我們的競爭對手。

儘管我們業務正錄得溢利，但我們依賴於純利為擴展計劃融資(假設截至二零一八年十二月三十一日止年度，我們的未來純利維持於相類水平為人民幣44.0百萬元及所有其他因素維持不變，包括但不限於售價及銷售成本維持不變且將不會分派股息予股東)，我們將需耗時約兩年以積累來自[編纂]的[編纂]淨額為約人民幣83.5百萬元。當我們為擴展計劃積累充足資金時，我們的競爭對手率先受益於市場增長。

[編纂]可降低流動資金風險及因倚賴於為擴展計劃融資的債務融資所產生的融資成本

於最後實際可行日期，我們的銀行融資已悉數動用，無抵押資產屬有限，及我們按公平值計入損益的金融資產已悉數抵押。於二零一九年四月三十日，無抵押物業、廠房及設備的賬面淨值為人民幣65.7百萬元。該等無抵押物業、廠房及設備主要包括(i)於二零一九年四月三十日，賬面淨值為人民幣38.9百萬元且無法按下文所述的理由予以抵押的瀘州廠房機器；(ii)租賃物業裝修、汽車、辦公設備、傢俬及固定裝置(具低轉售價值及因此一般不會經銀行或金融機構接納為已抵押資產)；及(iii)因確認折舊開支所產生最低賬面淨值的深圳廠房機器。本集團已收到有關收購瀘州廠房機器的政府補助金及提供相關政府補助金的政府部門不允許本集團抵押該等機器以進行債務融資。然而，本集團已與主要往來銀行接洽以申請額外融資，從而為擴展計劃融資。鑒於我們的無抵押資產屬有限款項，故我們的額外融資申請被拒絕。由於債務融資於可預見期間不可行，我們的董事認為股權融資乃為我們的擴展計劃融資的唯一可用資金來源。

就上述目的而言，倘我們銀行同意授予我們額外銀行融資，我們於二零一九年四月三十日的銀行借貸將由人民幣248.4百萬元增至人民幣331.9百萬元及我們的資產負債比率將上升至193.8%。截至二零一八年十二月三十一日止年度，假設年利率為5%，我們的融資成本將增加人民幣4.2百萬元。我們償還上述額外銀行借貸將需耗時約兩年，且倘我們截至二零一八年十二月三十一日止年度動用溢利償還上述額外銀行借貸(假設截至二零一八年十二月三十一日止年度，我們的未來純利維持於相類水平為人民幣44.0百萬元及所有其他因素維持不變，包括但不限於售價及銷售成本維持不變且將不會分派股息予股東)，我們亦將於該兩年內產生融資成本約人民幣8.4百萬元。

未來計劃及[編纂]用途

我們的董事認為過度倚賴於債務融資將令我們面臨巨大流動資金風險，尤其是出現任何不可預見經濟下行的時候，且額外融資成本亦將影響我們的財務表現。[編纂]可提供另外一種融資來源，使我們實現擴展計劃及降低上述潛在的流動資金風險。[編纂]地位亦於需要時為我們的未來資金融資提供平台，此舉將有利於本集團長期上的整體發展。

本集團業務的可持續性

全球手機市場的市場規模龐大(按銷售額計)且將繼續增長

人們的日常生活已經離不開手機。全球手機銷售額由二零一四年的4,042億美元增長至二零一八年的4,883億美元，複合年增長率為4.8%。由於5G手機的推出及新興市場可支配收入增加將刺激消費者購買新手機，預計全球手機銷售額將自二零一八年以3.2%的複合年增長率進一步增長，二零二三年達到5,790億美元。

手機製造業的上游市場參與者包括手機組件製造商及操作系統及應用軟件之供應商。中游市場參與主要包括ODM、OEM及OBM。ODM負責為手機品牌商進行手機的設計、研發及生產。主要ODM廠商包括聞泰、華勤及龍旗。OEM負責按照手機品牌商的設計及品牌生產手機。主要OEM廠商包括富士康、和碩、比亞迪及英業達。主要OBM廠商包括三星、OPPO及VIVO，其進行自有品牌手機的設計及製造。主要手機品牌商包括蘋果、華為及小米。為降低成本及提高產品開發效率，行業慣例是手機品牌商委聘中國的ODM研發及生產手機，而中國的ODM生產手機。手機品牌商通過將設計、研發及生產外包給ODM或將生產外包給OEM，能夠專注於向終端用戶進行手機的營銷及分銷。

根據灼識諮詢報告，中國手機ODM製造的手機出貨量由二零一四年的557.2百萬台增加至二零一八年的608.5百萬台，並預計將於二零二三年達到645.0百萬台，二零一八年至二零二三年期間的複合年增長率為1.2%。中國OEM手機出貨量由二零一四年的742.9百萬台增加至二零一八年的753.2百萬台，並預計將於二零二三年達到781.2百萬台。中國OBM手機出貨量由二零一四年的382.0百萬台增加至二零一八年的436.7百萬台，而由於預測OBM會將其製造流程外包予OEM或ODM，預計OBM手機出貨量將於2023年減至390.6百萬台。

未來計劃及[編纂]用途

本集團是中國手機ODM市場領先的市場參與者之一

中國手機ODM市場相對集中，由於市場參與者日益極化，預期其將更為集中。按手機單位出貨量計，市場參與者前十名合共佔中國手機ODM市場全部市場份額之58.3%。於二零一八年，本集團之市場份額為3.3%，於中國手機ODM市場排名第五。由於本集團是中國手機ODM市場領先的市場參與者之一且全球手機市場龐大，本集團於二零一六財年、二零一七財年及二零一八財年各年分別錄得收益人民幣2,171.9百萬元、人民幣2,889.7百萬元及人民幣2,943.7百萬元，複合年增長率為16.4%。

本集團的銷售面向印度及其他新興市場頂尖的本地手機品牌供應商、電信營運商及貿易公司，該等公司佔據巨大的市場份額

根據灼識諮詢報告，全球手機市場的未來增長將主要由亞洲新興國家(不包括中國)推動。亞洲新興國家(不包括中國)見證由二零一四年至二零一八年以複合年增長率為11.8%之智能手機單位出貨量之最快增長速度。亞洲新興國家(不包括中國)之龐大人口基礎、現時低水平的智能手機滲透率以及中國手機品牌商於亞洲新興國家(不包括中國)的高研發及廣告投資將帶動於亞洲新興市場(不包括中國)的智能手機單位出貨量於二零一八年至二零二三年以複合年增長率10.9%增長。

根據灼識諮詢報告，二零一八年印度、阿爾及利亞、巴基斯坦和孟加拉國的手機市場由(i)手機品牌商主導，如三星、蘋果、華為、小米、OPPO及VIVO；及(ii)頂尖的本地手機品牌供應商、電信營運商及貿易公司，如Micromax、Lava、Condor、Qmobile及Symphony。

本地電信運營商通常更加注重服務，通過升級實體店營造良好的客戶體驗，而與運營商保持良好關係對ODM增加銷售而言至關重要。預計新興亞洲國家(不包括中國)的競爭格局將日益激烈。低水平的智能手機滲透率已吸引許多公司，特別是吸引中國品牌在中國國內智能手機市場高度飽和的情況下尋求新的海外商機。

與中國其他手機ODM相比，本集團的銷售面向頂尖的本地手機品牌供應商、電信營運商及貿易公司，彼等於新興亞洲國家(不包括中國)亦佔據巨大的市場份額。我們來自亞洲新興國家(不包括中國)的收益由二零一六財年的人民幣1,939.7百萬元增加至二零一八財年的人民幣2,189.4百萬元，複合年增長率為6.2%。

未來計劃及[編纂]用途

我們的主要客戶包括(i) Lava (按二零一八年印度功能手機單位出貨量計排名第四)及Micromax (按二零一八年印度智能手機及功能手機單位出貨量計排名第六)；(ii) Condor (按二零一八年阿爾及利亞智能手機出貨量計排名第一)；(iii) Digicom QMobile (按二零一八年巴基斯坦智能手機單位出貨量計排名第五)；(iv) Symphony of Edison Group (按二零一八年孟加拉國智能手機單位出貨量計排名第一)，上述資料均來自灼識諮詢報告。

考慮到(i)全球手機市場的市場規模龐大(按銷售額計)且將繼續增長；(ii)本集團市場份額為3.3%，於二零一八年中國所有手機ODM中排名第五；(iii)本集團的主要客戶為於印度及其他新興市場佔據巨大市場份額的頂尖本地手機品牌供應商、電信營運商及貿易公司；及(iv)於二零一六財年、二零一七財年及二零一八財年，本集團銷售增長的複合年增長率為16.4%，董事認為我們的業務屬可持續發展。

[編纂]用途

於扣除[編纂]相關[編纂]佣金及估計開支後及假設[編纂]為每股股份0.55港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中間值)，以及假設[編纂]未獲行使，[編纂][編纂]淨額總額估計為[編纂]百萬港元。我們的董事擬將[編纂][編纂]淨額撥作以下用途：

- (1) [編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元，佔[編纂]淨額約[編纂]%)將用作提高瀘州廠房裝配印刷電路板組裝的產能。我們過往外包全部印刷電路板組裝(我們於二零一五年的主要產品之一及自二零一六年成為手機的重要模組)的裝配工作。為提升成本及生產效能，我們於二零一八年四月成立瀘州廠房並配備四條貼片線，年化產能達2.5百萬件。由於成本效能，我們通常僅為智能手機而非功能型手機生產印刷電路板組裝。於二零一八財年，我們的智能手機銷量為7.1百萬台及單獨出售印刷電路板組裝產品合共1.5百萬件。因此，我們於二零一八財年使用的智能手機印刷電

未來計劃及[編纂]用途

路板組裝產品的總量為8.6百萬片。根據瀘州廠房的現時年產能，我們仍須向電子製造服務提供商外包大部分印刷電路板組裝的裝配工作。因此我們計劃使用：

- [編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，以於二零一九年下半年為瀘州廠房購買新貼片線；及

下表載列將為新貼片線購置的各類機器及設備的套數及估計成本：

| 機器類型 | 套數 | 估計成本 人民幣千元 |
|-------------------|----|---------------|
| 貼片貼裝機(每條新貼片線配備五套) | 10 | [編纂] |
| 回流爐 | 2 | [編纂] |
| 錫膏印刷機 | 4 | [編纂] |
| 分板機 | 2 | [編纂] |
| 自動光學檢測機 | 4 | [編纂] |
| 3D錫膏檢查機 | 2 | [編纂] |
| X射線檢查機(附註1) | 1 | [編纂] |
| 自動化測試機器(附註2) | 5 | [編纂] |
| 紫外線印刷電路板激光打碼機 | 2 | [編纂] |
| 其他(附註3) | 32 | [編纂] |
| 總計 | 64 | [編纂] |

附註：

1. 我們計劃購買一台X射線檢查機，由兩條新貼片線共用。
2. 我們計劃購買四台綜合測試機器及一台首件測試機器，由兩條新貼片線共用。
3. 其他包括點膠機、輸送機、鋼網清洗機及風淋室。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，自二零二零年起聘用合共100名員工支援瀘州廠房經擴大生產規模；

下表載列將為貼片營運增聘的新員工人數(按職能及角色劃分)：

| 職能及角色 | 僱員人數 |
|-------------------------|------------|
| 錫膏印刷 | 8 |
| 高速貼片貼裝 | 8 |
| 回流前自動光學檢測 | 8 |
| 一般貼片貼裝 | 6 |
| 回流焊錫 | 4 |
| X射線檢測及自動光學檢測(包括X射線樣本檢查) | 16 |
| 印刷電路板組裝測試 | 32 |
| 印刷電路板組裝切割 | 10 |
| 倉庫及生產管理 | 8 |
| 總計 | <u>100</u> |

- (2) [編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元，佔[編纂]淨額[編纂]%)將用作增強研發能力，以豐富手機相關產品及物聯網相關產品的產品類別。我們計劃使用：

- [編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)購入各類測試機器，主要用於(i)預期將於二零二零年推出並將於未來數年迅速普及的5G手機產品及(ii)將於中國及全世界普及的物聯網相關產品的研發；及
- [編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)以於二零一九年十月額外聘用20名研發人員，該等員工預期於電子設備的研發上擁有較豐富的經驗，我們將優先僱傭該等擁有相關碩士或博士學位且在手機及物聯網產品上擁有5年或以上研發經驗的員工。我們已於二零一八年六月對5G智能手機開展研發工程及自二零一七年四月起擁有物聯網產品的研發項目並。於最後實際可行日期，我們目前從事物聯網及5G手機研發的員工人數分數為21名及15名。我們認為，基於以下原因，該等額外研發員工對我們未來研發活動而言屬必要：(i)根據灼識諮詢報告，更多國家支持推出5G，未來五至十年將會是5G時代，及我們需要更多有才能的研發人員以進一步提升我們的研發能力，從而加速我們對5G產品的研發；(ii)儘管我們目前僅有約十分之一的研發員工擁有相關碩士學位，但我們認為招募更多擁有碩士學位或以上的研發員工可提升我們對我們的5G及物聯網研發工程的研發能力。在該等20名額外研發員工中，分別有10名及5名

未來計劃及[編纂]用途

員工將從事對5G手機及物聯網產品的研發，而餘下五名員工將負責其他配套研發工程，如照相機模具及顯示器模具。我們認為我們的潛在客戶乃根據綜合性評估甄選ODM供應商，因此，研發能力乃可將我們與其他供應商區分開來的重要因素。

(3) 約[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元，佔[編纂]淨額[編纂]%)將用於增加銷售及市場推廣力度，以增強我們於印度的市場滲透及擴闊我們於北非等新興市場的客戶基礎以及於中國推廣智能定位器、智能音響、智能鎖等物聯網相關產品。我們計劃就此目的於二零一九年十月招聘15名銷售人員並計劃參加各類海外會展及貿易展，以向潛在新客戶推廣我們的產品。計劃詳情載列如下：

- 為提高我們於印度市場的滲透率，我們計劃招聘三名銷售專員，負責(i)對印度手機市場開展深度市場調研；(ii)維持密切溝通，如售後跟進回訪電話及年度客戶滿意度調查，加強我們與現有印度客戶的關係；(iii)物色潛在客戶並與之開展合作；及(iv)參加印度通訊展(Convergence India)及印度移動大會(India Mobile Congress)以進一步提高本公司在印度的知名度；
- 為擴大我們在中國的市場份額，我們計劃招聘四名銷售專員，專門與中國領軍品牌手機供應商建立業務關係。彼等工作範疇如下：(i)透過電子郵件、電話或面對面會議與潛在客戶的採購人員溝通，了解彼等需求；(ii)與我們研發團隊討論客戶需求；及(iii)向潛在客戶展示我們的新模型或設計並收集反饋；
- 為擴大我們在新興市場國家的客戶群及地域覆蓋範圍，我們計劃招聘三名銷售專員，彼等將(i)對其他新興市場，尤其是對南非及北非市場開展全面市場調研；(ii)與我們在其他新興市場國家的現有客戶保持密切溝通，並透過客戶轉介獲取更多的商機；及(iii)參加印度消費類電子展(CES)、世界移動通信大會(Mobile World Congress and Telecommunications)、計算機網絡貿易展(Computers Networks Trade Shows)，物色潛在客戶並向其推廣我們的產品；
- 為向中國推廣我們的物聯網產品，我們計劃招聘五名銷售專員。由於我們在物聯網市場資歷尚淺，該等銷售專員將盡最大努力向潛在客戶，尤其是向中國主要通訊運營商展示我們的物聯網相關產品，如智能定位器、智能音響及智能鎖。彼等亦將關注市場發展新趨勢、前沿技術及客戶對物聯網產品需求的轉變並制定業務發展計劃。

未來計劃及[編纂]用途

- (4) 約[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元，佔[編纂]淨額[編纂]%)將用於升級我們的電腦硬件、軟件及ERP系統，從而連接產品設計、成本預算、採購、生產計劃、存貨監控、質量控制及財務報告功能。
- (5) 約[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元，佔[編纂]淨額[編纂]%)將用於償還上海研發中心的部分按揭銀行貸款，其本金總額為人民幣[編纂]元，年息5.39%及於二零二七年到期；於二零一九年四月三十日，未償還按揭銀行貸款本金為人民幣[編纂]元；
- (6) 餘下結餘約[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元，佔[編纂]淨額[編纂]%)將用於額外營運資金及其他一般公司用途。

倘釐定之[編纂]高於或低於指示性[編纂]範圍之中間值，則將按比例調整上述[編纂]淨額之分配(用於償還貸款之[編纂]部分除外)。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的最高值)及假設[編纂]未獲行使，我們將收到額外[編纂]淨額[編纂]港元。倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的最低值)及假設[編纂]未獲行使，我們收到的[編纂]淨額將減少[編纂]港元。

倘[編纂]獲全面行使，我們估計將就[編纂]該等額外[編纂]收取額外[編纂]淨額(經扣除應付[編纂]費用及估計開支後)約(i)[編纂]港元(假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的最高值每股股份[編纂]港元)；(ii)[編纂]港元(假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的中間值每股股份[編纂]港元)；及(iii)[編纂]百萬港元(假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的最低值每股股份[編纂]港元)。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]均將按比例作上述分配。

倘[編纂]淨額毋須立即用於上述用途及在適用法律及法規准許情況下，我們擬將[編纂]淨額以短期活期存款形式存置於香港獲授權金融機構及／或持牌銀行。

未來計劃及[編纂]用途

實施計劃

下表載列自最後實際可行日期直至二零二零年十二月三十一日，我們業務策略的實施計劃：

| | 自最後實際 可行日期至 二零一九年 十二月三十一日 千港元 | 自二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 千港元 | 自二零二零年 七月一日至 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | 自二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 千港元 | 總計 千港元 | 將應用 [編纂]淨額之 百分比 % |
|-------------------------|---|--|--|--|-------------|----------------------------|
| 提升貼片產能 (附註1) | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 增強研發能力 (附註2及3) | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 加大銷售及市場推廣力 度以多樣化客戶基礎 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 升級ERP系統 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 償還銀行貸款 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 一般營運資金 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 總計： | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 將使用款項佔[編纂]淨額 之百分比： | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | |

附註：

- 為提升貼片產能，我們計劃動用[編纂]淨額為瀘州廠房增配兩條貼片生產線及增聘100名貼片生產員工。實施計劃按以下時間表進行：

| | 由最後實際 可行日期至 二零一九年 十二月三十一日 千港元 | 由二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 千港元 | 由二零二零年 七月一日至 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | 由二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 千港元 | 總計 千港元 |
|---------------|---|--|--|--|-------------|
| 兩條貼片生產線 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 就貼片營運招聘100名員工 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 小計： | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |

未來計劃及[編纂]用途

2. 為提升有關手機及物聯網相關產品之研發能力，須動用[編纂]淨額購買各項設備、機器及裝置。執行計劃按下列時間表載列：

| | 由最後實際 可行日期至 二零一九年 十二月三十一日 千港元 | 由二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 千港元 | 由二零二零年 七月一日至 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | 由二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 千港元 | 總計 千港元 |
|-----------------|---|--|--|--|-----------|
| 研發設備、機器及裝置 (附註) | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 招聘20名研發人員 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 小計 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |

附註：

設備／裝置及功能列表

設備數目

| | |
|---|----|
| ● 移動或無線裝置的設計應用程式 | 2 |
| ● 數據系統及部件設計的主動式高速探棒 | 2 |
| ● 密集型集成電路組件的被動式探棒或貼片裝置 | 2 |
| ● 無線及電池電源(6組)、電壓(1組)、耐雷擊突波(1組)、防水性(1組)、耐用性(1組)及電磁震動(1組)的測試機器及裝置 | 11 |
| ● 無線裝置的寬頻帶無線通訊測試儀(5G) | 1 |
| ● 頻譜分析儀(1組)及音頻分析儀(1組) | 2 |
| ● 先進的通訊質量分析系統 | 1 |
| ● 消音室(兩間)、熱衝擊試驗箱(1個)、恒濕試驗機(2組)及沙塵測試機(1組) | 6 |
| ● 調頻收擴機計算過濾器 | 1 |
| ● 音量控制器 | 2 |

未來計劃及[編纂]用途

3. 下表載列我們研發5G手機的計劃及時間表，以及有關研發活動所需的機器類型：

| 時間表 | 研發計劃 | 機器 |
|-----------------------|---|--|
| 自二零一八年六月至 二零一九年八月 | 5G頻率範圍所需原料的研發及天線設計，此為5G手機的關鍵研發步驟 | — 測試機以及無線及電力、電子電壓、防水及電磁振動的設備； — 用於數位系統及元件設計的有源高速探頭； |
| 自二零一九年八月至 二零一九年十二月 | 5G手機印刷電路板組裝所配備的無線電頻模組之研發，其負責無線電頻的傳輸及接收 | — 用於高密度積體電路元件或表面安裝設備的無源探頭； |
| 自二零一九年十二月至 二零二零二月 | 對各類移動晶片(如CPU及內存)的功能及兼容性進行檢測，並從不同供應商中選擇最佳組合的移動晶片 | — 無線設備寬頻無線通信測試儀； — 頻譜分析儀； — 先進的通訊質量分析系統 |
| 自二零二零年二月至 二零二零年三月 | 軟體發展及印刷電路板組裝佈局設計，優化5G手機的硬件及軟件的性能 | — 消聲室；及 — 開關擴大器測量濾器； |
| 自二零二零年四月至 二零二零年七月 | 5G手機的工業及機械設計 | — 設計手機及無線應用程式 |

根據灼識諮詢報告，預期自二零二零年以後，5G將普遍應用於商業領域，5G智能手機的安裝基站數預期將大量增加。截至二零二三年，世界範圍及中國的5G智能手機的安裝基站數將分別達到322.5百萬個及129.0百萬個。同樣根據灼識諮詢報告，中國四大智能手機品牌商計劃於二零一九年推出首批5G手機。自二零一九年三月起，中國移動集團已發佈兩批5G試驗型智能手機項目的公開招標邀請。

本集團透過對5G手機市場需求的預測，已開始向現有及潛在客戶推廣我們日後的5G手機。就已向我們購買2G、3G及4G的現有客戶而言，我們盡力了解其未來產品發展計劃、意向及推出5G手機的時間計劃並不時向其更新我們5G手機的最新研發進度。我們近期已收到Lava發出的5G手機模型設計及開發請求以及一名客戶(為中國知名品牌手機供應商)發出的5G手機競標邀請。我們相信，基於我們與該等客戶的良好業務關係，只要我們能夠提供符合其要求及產品規格的5G手機模型，彼等很大可能會向我們發出訂單。就潛在客戶而言，我們透過市場調研及與其管理團隊溝通，收集其5G計劃相關資料並優先與有5G計劃的潛在客戶建立關係。我們亦將透過參加或出席世界通訊展覽會，如消費類電子產品展覽會(CES)及移動世界大會，以及主要手機品牌商為推出其5G智能手機而召開的新聞發佈會，以尋找5G手機相關業務機會。

未來計劃及[編纂]用途

下表載列將予開發的物聯網相關產品類型及及有關研發活動所需的機器類型：

| 物聯網相關產品類型 | 描述／用途 | 機器 |
|-------------|--|--------------------------|
| 跟踪器系列 | 由老人、兒童或寵物攜帶，透過實時報告定位以防走失 | — 測試機及防水、防雷擊耐久性及電磁振動的設備； |
| 感應器系列 | 可應用於倉庫及各種工業用設備，如液壓傳感器及氣壓傳感器 | — 演播室監視器； — 音頻分析儀； |
| 車載終端系列 | 可安裝於汽車以實現車主遠程控制及／或透過記錄行車路線及速度、監控駕駛員活動及車距預警以及車道偏離預警提升駕駛安全 | — 消聲室； — 熱衝擊爐； |
| 智能學習機 | 可為用戶(主要為學生)的口頭或圖片提問搜索答案並答覆 | — 恆濕箱；及 — 沙塵試驗箱 |
| 智能支付及廣告終端系列 | 可使用面部／代碼掃描付款及／或展示各類廣告 | |